

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル
株式会社 ルネサス テクノロジ
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU&MCU	発行番号	TN-PMC-A001A/J	Rev.	第1版
題名	P-TFBGA1010-112 パッケージ仕様変更のご連絡		情報分類	パッケージ変更	
適用製品	HD64F2158VBP25	対象ロット等	関連資料	H8S/2158 ハードウェアマニュアル (ADJ-602-250A 第2版)	

拝啓 貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
題記の件、HD64F2158VBP25 におきまして P-TFBGA1010-112 のパッケージ仕様を下記の様に変更させていただきます。
この変更に伴い、製品型名、パッケージ外形、マーク仕様が変更となります。詳細は、以下をご参照願います。
敬具

1. 変更内容

	変更前	変更後
製品型名	HD64F2158VBP25	HD64F2158VBQ25
構造比較図		
モールド方式	パッケージ個々をトランスファーモールド	複数パッケージを一括トランスファーモールド
切断方法	金型による打ち抜き (テープ部) 切断	ダイサーによる切断
外形寸法図	-	2ページ目参照
マーク仕様	-	3ページ目参照

2. 変更理由

パッケージ仕様標準化による安定供給対応の為。

3. 製品特性、信頼度レベル

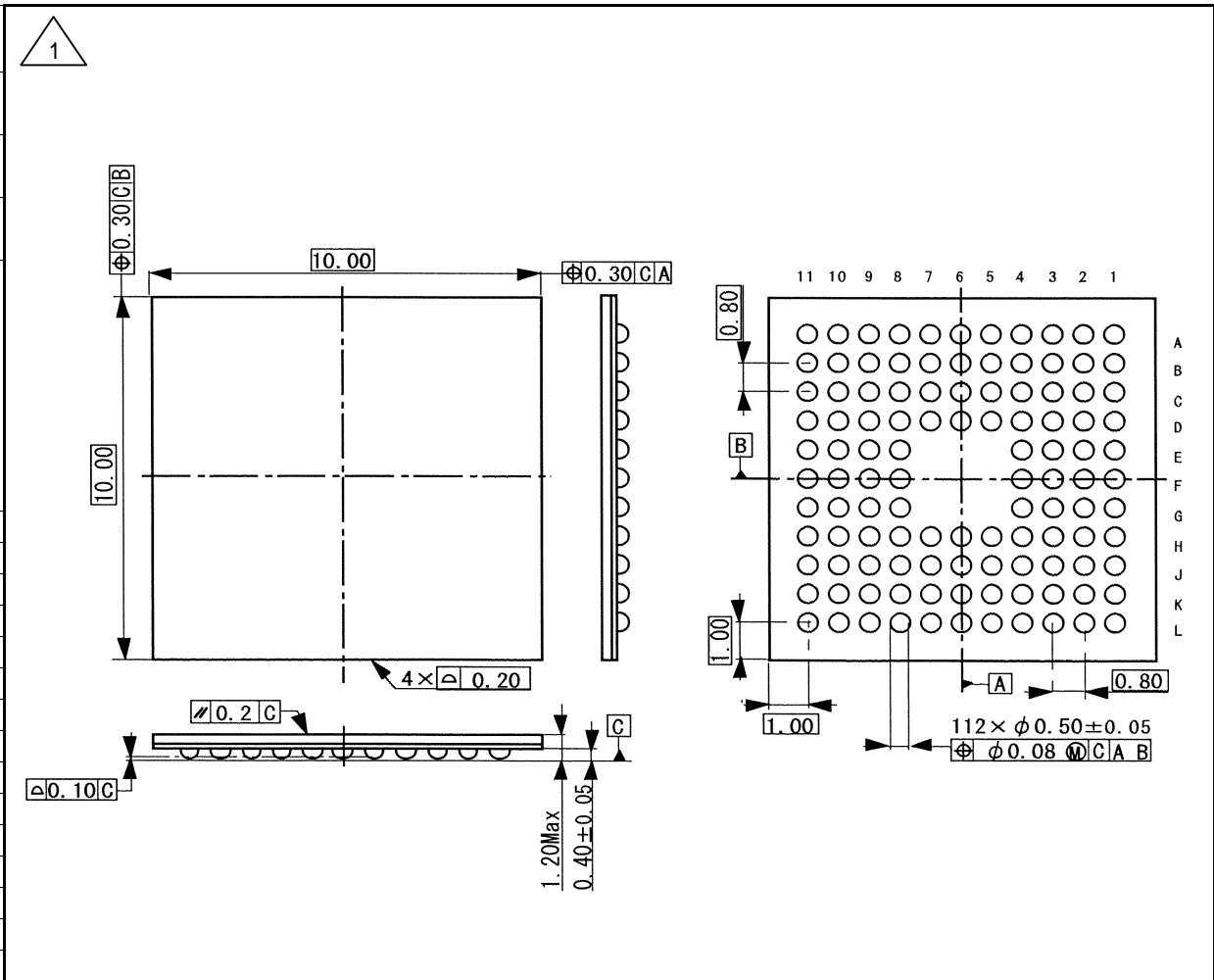
電气的特性及び信頼性レベルは同等です。

4. 切替

2004年12月生産分より切り替え予定です。

以上

SYM INPL	1	REVISIONS	P.1, W#PKGFTTR, S#4198	DATE	REVD.	CHKD.	APPD.
	1						
MW	D						
MQ	1						
MM3	1						
MM2	1						
MM1	1						
MA	1						
PROVI.	co						
SECT.	py						
D.CHKD	D						
	C						
	B						
	A						
	Gt.						



(単位 unit : mm)

パッケージコード (Package CODE)	TBP-112A TBP-112AV
JEDEC	—
JEITA	—
Mass (Reference value)	0.2 g

REMARKS		PROJECTION		TITLE		DWG.STAMP	
DWN.				FTR-OUTLN			
CHKD.		SCALE		顧客向け外形寸法図			
APPD.		NTS					
TBP-112A, TBP-112AV		REGD.		SD	TYPE	D.D	CLASS.
Gt. PKG CODE				E	50	AN	528
Renesas Technology Corp.				MD	WORK-SPEC No.		SH.
				E	PKGFTTR		1
				4198			E
				343 4Q01317			

